

グローバル戦略

グローバル事業のリスタート

中期経営計画2025に基づき、OKIは将来事業創出とグローバル事業のリスタートを掲げました。イノベーション戦略2025に基づく領域のみならず、事業性のある領域を明確にしながら、2031年に新規グローバル事業で500億円を目指します。事業推進については、現在海外で事業展開している拠点を前線基地化し、全員参加型イノベーションを各拠点にも定着させることで、海外からの事業発信もできるような体制を構築していきます。そのために、OKIでは各拠点を単なる販売拠点ではなく、イノベーションの拠点であるという意味で「Global Innovation Hub (GIH)」と呼称しています。2024年度には、このGIHのリーダーを国内に招集し、全役員とのディスカッション「Global Meeting」を実施し、国内と海外で共通認識を持ちながら事業推進しています。また、国内で培ったカルチャー改革の仕組みをGIHにも共有し、「イノベーション教育」、「Yume Proチャレンジ」、「加速支援コミュニティ」だけでなく、中核社員のネットワークを構築する「Yumeハブ」、イノベーション活動の情報共有を推進する「Yume Proフォーラム」、経営層と社員が直接対話する「イノベーション・ダイアログ/未来トーク」などのグローバル化も加速させていきます。

一方で、グローバルに事業展開するにあたり、現時点で事業化するためのキートン技術である技術が、自社に不足しているものもあります。これらの技術は、海外にオープンイノベーション拠点を配備し、事業に必要な技術を獲得して、成長させていきます。2024年5月に公表したとおり、シリコンバレーのPlug and Play社とパートナー契約を結び、スタートアップの技術探索を中心とするグローバルなオープンイノベーションを開始しました。これを皮切りに、欧州・アジアなど、拠点数を増やしていきながら、若手社員を派遣していきます。

こうした人的投資により、エッジプラットフォームに世界中の技術革新を取り込み、多様な社会課題のスピーディーな解決に貢献していきます。

CFBのグローバル展開

「CFB (Crystal Film Bonding)」は、OKIがLEDプリンター事業で培った半導体の異種材料接合技術です。2006年に、世界初となるLEDとICを機能融合した光電融合チップの量産化に成功し、18年間の量産実績を持つ成熟した技術です。OKIは、加速するDX、GXのため、それらを下支えする半導体デバイスの高機能化を目指し、CFBの普及を実現します。CFBは物質間の接合技術です。しかし、半導体産業において触媒のような役割を担うことで、オープン・イノベーションを活性化し、パートナーとともに新たなイノベーションを創出します。現在、CFBとの親和性が高いPhotonics、Micro-LED、Power、Analog-ICの4領域に注力し、さまざまなパートナーと連携して、2026年度からの事業化を目指し共創中です。さらに、社内各事業とのシナジー効果により、付加価値の高い商品・サービスの提供に貢献します。

